

TIF™700 系列热传导界面材料是填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。

其優異的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

- 》良好的热传导率: **13.0 W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

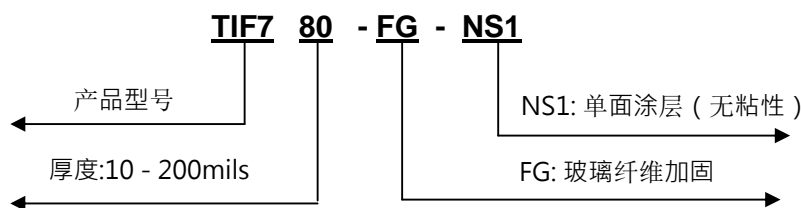
应用

- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视 LED灯具
- 》RDRAM内存模块
- 》微型热管散热器

TIF700系列特性表

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 颜色 | 灰色 | Visual | 击穿电压(T= 1mm 以上) | >5000 VAC | ASTM D149 |
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | ***** | 介电常数 | 4.5 MHz | ASTM D150 |
| 导热率 | 13.0W/mK | ASTM D5470 | 体积电阻率 | 6.2×10^{13} Ohm-meter | ASTM D257 |
| 硬度 | 45 Shore 00 | ASTM 2240 | 使用温度范围 | -40 To 200 °C | ***** |
| 比重 | 3.14 g/cc | ASTM D297 | 总质量损失 (TML) | 0.30% | ASTM E595 |
| 厚度范围 | 0.010"-0.200" (0.25mm-5.0mm) | ASTM D374 | 防火等级 | 94 V0 | UL E331100 |

产品型号编码说明:

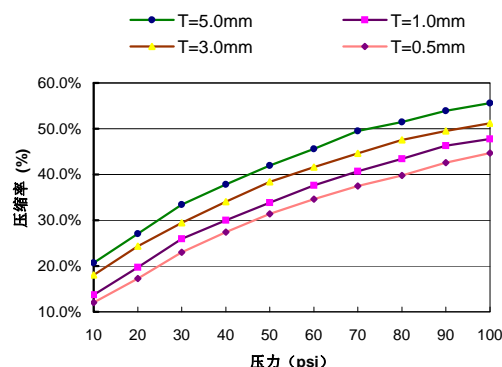


标准厚度:

0.010-inch to 0.200-inch (0.25mm to 5.0mm)

选项:

特殊NS1处理后可以产品单面无粘性



如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网：<http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大:
Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台湾:
Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

东莞:
Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:
Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:
Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证.用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。